



平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年8月10日

上場会社名 株式会社アバールデータ 上場取引所 東
 コード番号 6918 URL <http://www.avaldata.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 広光 勲
 問合せ先責任者 (役職名) 管理本部担当部長 (氏名) 大関 拓夫 (TEL) 042-732-1000
 四半期報告書提出予定日 平成28年8月10日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第1四半期	1,790	2.0	150	△14.8	160	△17.1	102	△16.2
28年3月期第1四半期	1,756	19.4	176	769.7	193	401.9	122	339.3

(注) 包括利益 29年3月期第1四半期 △15百万円(-%) 28年3月期第1四半期 109百万円(438.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年3月期第1四半期	17.20	17.15
28年3月期第1四半期	18.83	18.72

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
29年3月期第1四半期	10,480	8,700	77.4
28年3月期	10,776	8,855	75.6

(参考) 自己資本 29年3月期第1四半期 8,109百万円 28年3月期 8,145百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年3月期	—	8.00	—	17.00	25.00
29年3月期	—	—	—	—	—
29年3月期(予想)	—	12.00	—	15.00	27.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	3,495	5.6	345	28.1	355	21.0	230	15.9	38.53
通期	7,000	0.6	670	6.3	690	4.2	455	5.4	76.23

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
 新規 一社(社名) 、除外 一社(社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	29年3月期1Q	7,417,842株	28年3月期	7,417,842株
② 期末自己株式数	29年3月期1Q	1,445,476株	28年3月期	1,453,676株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	29年3月期1Q	5,968,743株	28年3月期1Q	6,509,647株

(注)当社は、信託型従業員持株インセンティブ・プランを導入しております。当該プランにかかる従持信託が所有する当社株式数については、四半期連結財務諸表において自己株式として表示していることから、当該従持信託が所有する当社株式数については、「期末自己株式数」に、29年3月期1Qは42,400株、28年3月期は46,600株をそれぞれ含めており、「期中平均株式数(四半期累計)」から29年3月期1Qは44,704株、28年3月期1Qは78,500株を控除しております。

なお、信託型従業員持株インセンティブ・プランの詳細については【添付資料】5ページ(3)「追加情報」に記載しております。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】4ページ(3)「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

なお、四半期決算補足説明資料は、平成28年8月10日(水曜日)に当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	5
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	5
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	5
(3) 追加情報	5
3. 四半期連結財務諸表	6
(1) 四半期連結貸借対照表	6
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
四半期連結損益計算書	8
四半期連結包括利益計算書	9
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	11
4. 補足情報	12
(1) 生産、受注及び販売の状況	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得の改善により景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、新興国経済の減速、英国のEU離脱や海外の政情不安に加え、為替相場や株式市場が大きく変動するなど依然として不透明な状況が続いています。

当社グループに関連深い半導体製造装置業界における、大手半導体メーカーの次世代プロセス関連の設備投資が継続するなか全般的な産業用装置における設備投資は回復基調にあり、受託製品、産業用制御機器および自社製品、画像処理モジュール関連が順調に推移いたしました。

このような経営環境のもと、当社グループは顧客満足度の更なる向上のために、市場ニーズを先取りした新製品の投入によりお客様の装置の競争力向上に貢献するとともに、品質面で更なる微細化への対応のため、最新検査装置の導入と工場のクリーン化に積極的に取り組みを行っております。

この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は1,790百万円（前年同四半期比2.0%増）、営業利益は150百万円（前年同四半期比14.8%減）、経常利益は160百万円（前年同四半期比17.1%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は102百万円（前年同四半期比16.2%減）となりました。

当社グループでは、事業内容を2つの報告セグメントに分けております。当第1四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は次のとおりであります。

① 受託製品

当該セグメントは、半導体製造装置関連、産業用制御機器および計測機器の開発・製造・販売を行っております。半導体製造装置関連市場におきましては、大手半導体メーカーの設備投資が継続しており、産業用制御機器及び計測機器におきましては、従来顧客の安定的な需要に加え、新規顧客の営業展開が進んだことにより、受託製品全般において堅調に推移いたしました。

この結果、売上高は1,200百万円（前年同四半期比4.8%増）、セグメント営業利益は174百万円（前年同四半期比5.4%増）となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 半導体製造装置関連

当該品目は、半導体製造装置の制御部を提供しております。大手半導体メーカーの3D-NAND向け設備投資は継続しておりますが、前年同四半期に売上が集中したことにより、前年同四半期に比し、当第1四半期連結累計期間における売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は686百万円（前年同四半期比10.7%減）となりました。

ロ) 産業用制御機器

当該品目は、各種の産業用装置、社会インフラ関連の制御部の開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。産業用装置の新規展開が順調に進んだことに加え、社会インフラ関連が堅調であったため、売上高は大幅に増加いたしました。

この結果、売上高は225百万円（前年同四半期比65.9%増）となりました。

ハ) 計測機器

当該品目は、各種計測機器のコントローラ、通信機器の制御部の開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。各種計測機器の需要は回復傾向にあり、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は287百万円（前年同四半期比19.7%増）となりました。

② 自社製品

当該セグメントは、組込みモジュール、画像処理モジュールおよび計測通信機器の開発・製造・販売並びにこれらに付属する周辺機器およびソフトウェア等の自社製品関連商品の販売を行っております。全般的な産業用装置における設備投資は回復基調にあり、加えて新分野への開拓も順調に進みましたが、自社製品全体では、売上高はわずかながら減少いたしました。

この結果、売上高は590百万円（前年同四半期比3.4%減）、セグメント営業利益は107百万円（前年同四半期比21.8%減）となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 組込みモジュール

当該品目は、半導体製造装置、FA全般、電力・通信関連向けに提供しております。FA全般および医療機器関連における新規受注は堅調に推移しておりますが、前年同四半期に受注が集中したことにより、前年同四半期に比し、当第1四半期連結累計期間における売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は102百万円（前年同四半期比20.6%減）となりました。

ロ) 画像処理モジュール

当該品目は、FA全般、各種検査装置、液晶関連機器に提供しております。各種検査装置においては積極的な新製品開発の推進に加え、食品、医薬品などの新分野開拓も順調に進み、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は224百万円（前年同四半期比19.1%増）となりました。

ハ) 計測通信機器

当該品目は、超高速シリアル通信モジュール「GiGA CHANNEL」シリーズ、FAXサーバ・コールセンター向けCTI (Computer Telephony Integration) ・リモート監視機器およびスマート電源装置を提供しております。「GiGA CHANNEL」シリーズ関連は、新規検査装置向けの開拓が順調に進みましたが、CTI関連の需要が一巡したため、売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は206百万円（前年同四半期比8.9%減）となりました。

ニ) 自社製品関連商品

当該品目は、自社製品の販売促進とシステム販売による高付加価値化を図るため、ソフトウェアおよび付属の周辺機器を提供しております。省エネ関連機器が一段落したため、売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は56百万円（前年同四半期比14.6%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における資産は10,480百万円（前連結会計年度末比295百万円の減少）となりました。

流動資産につきましては、主に、増加要因として、現金及び預金が102百万円増加となり、減少要因として、受取手形及び売掛金が67百万円、電子記録債権が54百万円、たな卸資産(商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)が84百万円、その他が主に繰延税金資産の減少等により18百万円、それぞれ減少となりました。この結果、122百万円減少し7,302百万円となりました。

固定資産につきましては、主に、有形固定資産が14百万円増加、投資その他の資産が投資有価証券の時価変動の影響等により185百万円減少しております。この結果、172百万円減少し3,178百万円となりました。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における負債は1,780百万円（前連結会計年度末比139百万円の減少）となりました。

流動負債につきましては、主に、増加要因として、支払手形及び買掛金が47百万円、その他が未払金の増加等により143百万円、それぞれ増加となり、減少要因として、未払法人税等が103百万円、賞与引当金が141百万円、役員賞与引当金が22百万円、それぞれ減少となりました。この結果、76百万円減少し1,544百万円となりました。

固定負債につきましては、主に、退職給付に係る負債が4百万円、その他が繰延税金負債の減少等により56百万円、それぞれ減少した結果、63百万円減少し236百万円となりました。

なお、負債項目に記載しております、1年内返済予定の長期借入金および長期借入金は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」によるものであります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産は8,700百万円（前連結会計年度末比155百万円の減少）となりました。

主に、資本剰余金が88百万円増加し、その他有価証券評価差額金が130百万円、非支配株主持分が119百万円それぞれ減少しております。なお、自己株式が5百万円減少しておりますが、ストックオプション行使によるものが2百万円、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」によるものが2百万円となります。

(自己資本比率)

当第1四半期連結会計期間末における自己資本比率は77.4% (前連結会計年度末比1.8ポイントの増加) となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の予想につきましては、概ね計画通りに推移しており、現時点では、平成28年5月13日付「平成28年3月期決算短信」に公表いたしました数値からの変更はございません。

また今後、当社グループを取り巻く環境が著しく変化した場合等、業績に影響を及ぼす事態が生じた場合には速やかに適時開示を行います。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はございません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額はありません。

(3) 追加情報

(信託型従業員持株インセンティブ・プランの会計処理について)

本プランでは、当社が信託銀行に「アバールグループ社員持株会専用信託口」(以下「従持信託」といいます。)を設定し、従持信託は、本プランを導入後6年間にわたり「アバールグループ社員持株会」(以下「本持株会」といいます。)が取得すると見込まれる規模の当社株式312,400株を予め取得いたします。その後、従持信託から本持株会に対して毎月当社の株式を売却いたします。なお、従持信託は当社株式を取得するための資金確保のため、当社保証の銀行借入を行っております。

信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額等が累積した場合には、当該株式売却益相当額等が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残高について、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約書に基づき、当社が弁済することとなります。

従持信託が所有する当社株式を含む資産及び負債ならびに費用及び収益については、当社と従持信託は一体であるとし、当社の四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書に含めて処理しております。これに伴い従持信託が実行した借入金残高 51,610千円(前連結会計年度末 51,610千円)を四半期連結貸借対照表に計上しております。また、従持信託が所有する株式については純資産の部に自己株式として表示しており、当四半期連結会計期間末(平成28年6月30日)における自己株式の帳簿価額及び株式数は、以下のとおりであります。

純資産の部の自己株式の帳簿価額 1,034,668千円、自己株式数 1,445,476株(前連結会計年度末 1,040,236千円、1,453,676株)。

うち、当社所有の自己株式の帳簿価額 1,007,447千円、自己株式数 1,403,076株(前連結会計年度末 1,010,319千円、1,407,076株)。

うち、従持信託所有の自己株式の帳簿価額 27,220千円、自己株式数 42,400株(前連結会計年度末 29,917千円、46,600株)。

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,941,898	4,044,266
受取手形及び売掛金	1,354,708	1,287,481
電子記録債権	455,747	401,152
有価証券	10,175	10,175
商品及び製品	381,546	392,105
仕掛品	277,939	244,938
原材料及び貯蔵品	769,170	706,899
その他	233,673	215,266
流動資産合計	7,424,860	7,302,286
固定資産		
有形固定資産		
土地	1,316,699	1,316,699
その他(純額)	764,928	779,068
有形固定資産合計	2,081,628	2,095,768
無形固定資産		
	67,156	65,480
投資その他の資産		
投資有価証券	1,148,838	964,414
その他	83,137	82,488
貸倒引当金	△29,556	△29,546
投資その他の資産合計	1,202,418	1,017,356
固定資産合計	3,351,203	3,178,604
資産合計	10,776,064	10,480,891

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	849,010	896,980
1年内返済予定の長期借入金	26,000	26,000
未払法人税等	143,357	39,422
賞与引当金	267,871	126,670
役員賞与引当金	28,374	6,119
その他	306,302	449,500
流動負債合計	1,620,914	1,544,692
固定負債		
長期借入金	25,610	25,610
役員退職慰労引当金	67,502	65,402
退職給付に係る負債	49,177	44,242
その他	156,866	100,862
固定負債合計	299,156	236,117
負債合計	1,920,070	1,780,810
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,354,094	2,354,094
資本剰余金	2,444,942	2,533,221
利益剰余金	4,012,707	4,012,515
自己株式	△1,040,236	△1,034,668
株主資本合計	7,771,508	7,865,163
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	374,158	244,099
その他の包括利益累計額合計	374,158	244,099
新株予約権	3,948	3,572
非支配株主持分	706,378	587,246
純資産合計	8,855,993	8,700,081
負債純資産合計	10,776,064	10,480,891

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
売上高	1,756,510	1,790,953
売上原価	1,164,347	1,199,981
売上総利益	592,162	590,972
販売費及び一般管理費	415,957	440,833
営業利益	176,205	150,138
営業外収益		
受取利息	230	210
受取配当金	15,382	5,560
助成金収入	1,500	4,224
その他	785	711
営業外収益合計	17,897	10,707
営業外費用		
支払利息	110	59
支払手数料	41	35
営業外費用合計	151	94
経常利益	193,951	160,750
特別損失		
固定資産売却損	161	—
固定資産除却損	12	—
特別損失合計	174	—
税金等調整前四半期純利益	193,777	160,750
法人税、住民税及び事業税	14,616	26,911
法人税等調整額	48,419	19,401
法人税等合計	63,036	46,313
四半期純利益	130,740	114,437
非支配株主に帰属する四半期純利益	8,166	11,746
親会社株主に帰属する四半期純利益	122,574	102,691

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
四半期純利益	130,740	114,437
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△21,058	△130,058
その他の包括利益合計	△21,058	△130,058
四半期包括利益	109,682	△15,621
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	101,516	△27,367
非支配株主に係る四半期包括利益	8,166	11,746

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年6月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	受託製品	自社製品	合計
売上高			
外部顧客への売上高	1,145,545	610,964	1,756,510
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	1,145,545	610,964	1,756,510
セグメント利益	165,999	136,901	302,900

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利 益	金 額
報告セグメント計	302,900
セグメント間取引消去	—
全社費用(注)	△126,694
四半期連結損益計算書の営業利益	176,205

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	受託製品	自社製品	合計
売上高			
外部顧客への売上高	1,200,503	590,450	1,790,953
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	1,200,503	590,450	1,790,953
セグメント利益	174,963	107,059	282,022

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利 益	金 額
報告セグメント計	282,022
セグメント間取引消去	—
全社費用(注)	△131,884
四半期連結損益計算書の営業利益	150,138

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四半期比 (%)	金額(千円)	前年同四半期比 (%)
受託製品				
半導体製造装置関連	521,868	8.1	540,189	3.5
産業用制御機器	97,737	△5.5	153,118	56.7
計測機器	188,056	△7.5	197,344	4.9
小計	807,662	2.3	890,652	10.3
自社製品				
組込みモジュール	78,850	51.7	67,393	△14.5
画像処理モジュール	102,365	33.0	113,513	10.9
計測通信機器	101,787	17.8	95,149	△6.5
小計	283,002	31.4	276,057	△2.5
合計	1,090,665	8.5	1,166,709	7.0

- (注) 1 金額は製造原価にて表示しております。
 2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
 3 自社製品セグメントにおいては、記載した詳細品目に付属する周辺機器の提供として、自社製品関連商品の販売を行っておりますが、当該仕入実績は、② 商品仕入実績として別途記載しております。

② 商品仕入実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四半期比 (%)	金額(千円)	前年同四半期比 (%)
自社製品				
自社製品関連商品	57,424	214.1	43,832	△23.7
合計	57,424	214.1	43,832	△23.7

- (注) 1 金額は仕入価格にて表示しております。
 2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

③ 受注状況及び販売状況

イ) 受注高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四半期比 (%)	金額(千円)	前年同四半期比 (%)
受託製品				
半導体製造装置関連	561,532	2.4	672,497	19.8
産業用制御機器	194,231	61.9	233,389	20.2
計測機器	270,837	21.9	111,123	△59.0
小計	1,026,602	15.3	1,017,010	△0.9
合計	1,026,602	15.3	1,017,010	△0.9

ロ) 受注残高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四半期比 (%)	金額(千円)	前年同四半期比 (%)
受託製品				
半導体製造装置関連	251,021	32.3	305,381	21.7
産業用制御機器	265,144	97.8	259,666	△2.1
計測機器	298,528	59.2	213,710	△28.4
小計	814,693	59.3	778,758	△4.4
合計	814,693	59.3	778,758	△4.4

ハ) 販売実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四半期比 (%)	金額(千円)	前年同四半期比 (%)
受託製品				
半導体製造装置関連	769,053	25.2	686,975	△10.7
産業用制御機器	136,137	△6.8	225,809	65.9
計測機器	240,355	△0.3	287,718	19.7
小計	1,145,545	14.4	1,200,503	4.8
自社製品				
組込みモジュール	129,621	44.1	102,883	△20.6
画像処理モジュール	188,453	25.2	224,533	19.1
計測通信機器	226,534	16.9	206,341	△8.9
自社製品関連商品	66,354	91.4	56,691	△14.6
小計	610,964	30.3	590,450	△3.4
合計	1,756,510	19.4	1,790,953	2.0

- (注) 1 金額は販売価格にて表示しております。
2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3 受注高及び受注残高は受託製品セグメントの内容であり、自社製品セグメントにおいては、需要予測に基づく見込生産を行っているため、該当事項はありません。